

苏州圣全科技有限公司 重庆AOI检测机

产品名称	苏州圣全科技有限公司 重庆AOI检测机
公司名称	苏州圣全自动化设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市工业园区亭翔街3号
联系电话	13812633160 13812633160

产品详情

由于IC芯片比较精密主要由微型电子器件或部件构成。采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构；其中所有元件在结构上已组成一个整体，使电子元件向着微小型化、低功耗和高可靠性方面迈进了一大步。但越精密的电路，检测难度就越复杂。当前芯片检验的常用方法通常是将芯片层层剥开，再用电子显微镜对每一层表面进行拍摄，这样检测方式对芯片具有极大破坏性，此时，X-ray无损检测设备可提供解决方案。

6. X射线成像技术在BGA焊接质量检测中的应用

BGA（球栅阵列封装）是一种典型的高密度封装技术，其特点是芯片引脚以球形焊点按阵列形式分布在封装下面，可使器件更小、引脚数更多、引脚间距更大、成品组装率更高和电性能更优良。

目前BGA焊接质量检测手段非常局限，AOI检测机，常用的检测手段包括：目检、飞针电子测试、X射线检测、染色检测和切片检测。其中染色和切片检测为破坏性检测，可作为失效分析手段，不适于焊接质量检测。无损检测中目检仅能检测器件边缘的焊球，不能检测焊球内部缺陷；飞针电子测试误判率太高；而X射线检测利用X射线透射特性，可以很好地检测隐藏在器件下方的焊球焊接情况，是目前很有效的BGA焊接质量检测方法。

X-RAY设备是用来做什么？

- 1、表面贴装工艺焊接性检测：主要是用来对焊点空洞的检测和测量；
- 2、印刷电路板制造工艺检测：通过XRAY设备对焊线偏移，桥接，开路进行检测；
- 3、集成电路的封装工艺检测：对层剥离、开裂、空洞和打线工艺等进行检测；

- 4、芯片尺寸量测，打线线弧量测等；
- 5、锡球数组封装及覆芯片封装中锡球的完整性检验；
- 6、高密度的塑料材质裂开或金属材质检验；
- 7、连接线路检查：开路，短路，异常或不良连接的缺陷。

苏州圣全科技有限公司-重庆AOI检测机由苏州圣全科技有限公司提供。苏州圣全科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！